

第十回 4 セラミックス研究機関合同講演会

主催： 東京工業大学応用セラミックス研究所
名古屋工業大学、(財)ファインセラミックスセンター、(独)物質・材料研究機構
協賛： 日本セラミックス協会
日時： 2010 年1 月19 日(火) 午後1:00~
場所： 東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール
(東急田園都市線すずかけ台駅下車徒歩5 分)
参加費無料 (懇親会参加費を当日2,000 円申し受けます。)

プログラム

- 1:00~1:10 ご挨拶
岡田 清 応用セラミックス研究所長
- 1:10~1:40 「粉末X線回折測定における粒子統計解析」
井田 隆准教授
(名古屋工業大学 未来材料創成工学専攻 セラミックス基盤工学研究センター)
- 1:40~2:20 「ポリマープレカーサー法による多孔質セラミック薄膜の合成
- 高温ガス分離膜の創製を目指して -」
岩本 雄二教授 (名古屋工業大学 未来材料創成工学専攻)
- 2:20~2:50 「超硬工具向けタングステン代替材料のためのサーメット・コーティング技術
の開発」
松田 哲志主任研究員((財)ファインセラミックスセンター 材料技術研究所)
- 2:50~3:30 「マルチセラミックス膜新断熱材料の開発」
奥原 芳樹主任研究員((財)ファインセラミックスセンター 材料技術研究所)
- 3:30~4:00 コーヒーブレイク
- 4:00~4:30 「圧電係数 d_{33} が600pC/N を超える非鉛圧電材料」
任 暁兵グループリーダー((独)物質・材料研究機構)
- 4:30~5:10 「鉄系超伝導体の超高压合成」
室町 英治フェロー ((独)物質・材料研究機構 世界研究拠点PI)
- 5:10~5:50 「金属ナノ粒子を用いたボトムアップデバイスの創製」
真島 豊教授 (東京工業大学応用セラミックス研究所)
- 6:00~7:30 懇親会

参加申込： Fax: 045-924-5978 kenkyushien@msl.titech.ac.jp (共同利用・研究支援室)

お問合せ： E-mail: k-hayashi@lucid.msl.titech.ac.jp Tel: 045-924-5337 (林 克郎)

Fax: 045-924-5978 E-mail: kenkyushien@msl.titech.ac.jp

1 月11 日(月)までご返事をお願い申し上げます。

第十回 4 セラミックス研究機関合同講演会 参加申込書

日時： 2010 年1 月19 日(火) 午後1:00~

場所： 東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール

お名前:	
ご所属:	
所在地: 〒	
Tel:	Fax:
E-mail:	
懇親会: 参加(¥ 2,000) 不参加	
コメント・ご要望	